GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/172 VAN DE COMMISSIE

van 16 november 2018

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in „flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ([1]), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2011/65/EU verplicht lidstaten ervoor te zorgen dat elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht, geen van de gevaarlijke stoffen bevat die zijn opgenomen in bijlage II bij die richtlijn. Dit vereiste geldt niet voor de toepassingen die zijn vermeld in bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU.

(2) De verschillende categorieën elektrische en elektronische apparatuur waarop Richtlijn 2011/65/EU van toepassing is (categorieën 1 tot en met 11), zijn opgenomen in bijlage I bij die richtlijn.

(3) Lood is opgenomen in bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU als stof waarvoor beperkingen gelden. Het gebruik van lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in „flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen werd echter vrijgesteld van de beperking en is momenteel opgenomen in rubriek 15 van bijlage III bij die richtlijn. De vrijstelling voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10 was geldig tot 21 juli 2016.

(4) De Commissie heeft vóór 21 januari 2015 een aanvraag ontvangen om verlenging van die vrijstelling overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2011/65/EU. De vrijstelling blijft gelden totdat een besluit over die aanvraag is genomen.

(5) Loodhoudende soldeer wordt gebruikt in „flip chip"-verbindingen, in de vorm van bolletjes waarmee die's aan de chipdrager worden bevestigd. De soldeermaterialen moeten bij de uitzonderlijk hoge stroomdichtheden die nodig zijn, bestand zijn tegen falen als gevolg van elektromigratie en in staat zijn een soldeerhiërarchie te creëren die gefaseerde montage en herbewerking van componenten tijdens het fabricageproces mogelijk maakt. Zij moeten ook in hoge mate plastisch vervormbaar zijn ter vermindering van thermomechanische stress in de metallurgische structuren onder de bolletjes, met name bij grotere chipplaatjes.

(6) Voor bepaalde toepassingen die vallen onder de huidige vrijstelling, is het nog steeds wetenschappelijk en technisch niet haalbaar om lood te vervangen of te verwijderen, vanwege het ontbreken van betrouwbare vervangende stoffen. De vrijstelling zwakt de door Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad ([2]) geboden milieu- en gezondheidsbescherming niet af. Zij moet derhalve voor die specifieke toepassingen worden verlengd.

(7) Voor alle andere, momenteel onder de vrijstelling vallende toepassingen is niet voldaan aan de voorwaarden voor verlenging. De vrijstelling voor die toepassingen moet gedurende twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze gedelegeerde richtlijn blijven gelden in overeenstemming met artikel 5, lid 6, van Richtlijn 2011/65/EU.

(8) Aangezien er voor de bij de verlenging betrokken toepassingen geen betrouwbare alternatieven op de markt beschikbaar zijn, moet de vrijstelling voor die toepassingen voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10 worden verlengd voor een duur van maximaal vijf jaar, tot en met 21 juli 2021. Gezien de resultaten van de lopende inspanningen om een betrouwbare vervanger te vinden, is het onwaarschijnlijk dat de duur van de vrijstelling negatieve gevolgen voor de innovatie zal hebben.

([1]) PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.

([2]) Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(9) Voor andere categorieën dan de categorieën 1 tot en met 7 en 10 blijft de huidige vrijstelling gelden gedurende de in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2011/65/EU vastgestelde perioden. De vervaldata moeten omwille van de duidelijkheid worden opgenomen in bijlage III bij die richtlijn.

(10) Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, uiterlijk op 29 februari 2020 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 maart 2020.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 november 2018.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

In bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt rubriek 15 vervangen door:

„15	Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in „flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen	Geldt voor de categorieën 8, 9 en 11, en verstrijkt op: — 21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur; — 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; — 21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
15(a)	Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in „flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen waarbij ten minste wordt voldaan aan een van de volgende criteria: — halfgeleidertechnologieknoop van 90 nm of groter; — een enkele die van 300 mm^2 of groter, in om het even welke halfgeleidertechnologieknoop; — pakketten gestapelde die's van 300 mm^2 of groter, of „silicon interposers" van 300 mm^2 of groter.	Geldt voor de categorieën 1, 7 en 10, en verstrijkt op 21 juli 2021."